

江蘇芯德半導體科技股份有限公司

Jiangsu Xinde Semiconductor Technology Co., Ltd.

股份代號： 7672 主板

公開發售價

HK\$ 8.60 - 9.60 港元

半導體

回撥機制 B: 公開認購 10%份額(無強制回撥)

背景/業務

江蘇芯德半導體是一家半導體封測服務提供商，主要從事開發封裝設計、提供定制封裝產品以及封裝產品測試服務。根據弗若斯特沙利文的資料，在晶體管密度增長接近其規模極限的「後摩爾時代」，依靠新型半導體封裝架構（例如小型化、薄型化、高效率、異質集成等封裝技術）作為連接芯片設計與應用的關鍵環節成為了提升芯片性能、效率及功能靈活性的關鍵驅動力。芯德半導體是中國具備傳統及先進封裝技術能力的企業之一，能夠在「後摩爾時代」推動半導體創新取得突破並支持「AI+時代」的發展浪潮。

[請點擊此參閱招股文件](#)

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2023	2024	2025
收益	509,077	827,374	1,012,159
其他（虧損）及收益	70,597	101,699	68,326
除稅前溢利/虧損	(358,892)	(376,578)	(483,088)
期內溢利/虧損	(358,892)	(376,578)	(483,088)
未經審計備考經調整 每股有形資產淨值	2.12 - 2.22 港元		
2025 歷史市盈率	N/A		
推薦人/ 牽頭經辦人	華泰國際		

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。輝立證券(香港)有限公司(或其任何附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有所述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所述公司有關係的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所述及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

經輝立證券申請截止認購日期

11 月 5 日（四）上午 10:15

全數付款客戶：一律\$0 手續費

NEW 9 成孖展 電子帳單客戶優惠:

- 認購 50 -1,000 股，免利息及手續費
 - 認購 1,500 -5,000 股，免息只需\$28 手續費
 - 認購 6,000 -10,000 股，免息只需\$68 手續費
 - 認購 HK\$10 萬以上認購金額手續費一律\$88
- (*非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	106,562,500 股 H 股
公開發售: 10,656,500 股 H 股	
配售: 95,906,000 股 H 股	
集資總額	\$ 1,023 百萬港元(按最高發售價計)
集資淨額	\$ 904.3 百萬港元(HK\$9.10 計)
市值	HK\$9,164.4- 10,230.0 百萬港元
公開發售日	2026 年 10 月 30 日-2026 年 11 月 5 日
公開發售結果	11 月 6 日
孖展息率及計息日	0 % (1 日息)
上市日	11 月 10 日
每手股數	500 股

主要風險因素

1. 收入集中於消費電子及通訊行業；
2. 前五大客戶較為集中；
3. 需求預測與已確認採購訂單之間差異響訂單可見度；
4. 若干政府補助金及稅務優惠屆滿或變動；
5. 往績仍錄毛損及虧絀。

集資用途 (百分比)

1. 用於擴大產能及提升製造能力；	69.5%
2. 提升封裝技術的研發能力；	17.6%
3. 提升商業化能力及擴展協作系統；	2.9%
4. 用作營運資金及一般企業用途。	10%

注意：

- 申請結果公佈後，有關手續費將不予退還。
- 以上資料可予變動，並以招股書所載為準。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決定。
- 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及保留所有更改的最終決定權。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司